

- 专为微机电(MEMS)产品设计，实现客户在芯片级封装(CSP)的先进封装制程进行晶圆级的最终测试，简化生产制造流程，让客户的测试成本降到最低。
- 提供MEMS测试全面性的产品，包括晶圆探针测试，多种激励方式和封装选项的测试机以及三温测试。
- 使用Ring Frame方式进行测试，有别于传统Pick & Place，可避免元件损伤，提高生产效率。

# KRONOS

## 惯性传感器晶圆探针系统

- 可用于以下产品最终测试和校正
  - ✓ 加速度计
  - ✓ 磁力计
  - ✓ 陀螺仪
  - ✓ 电子指南针



# AIOLOS

## 压力感测器测试系统

- 可用于以下产品最终测试和校正
  - 压力和真空侦测传感器
  - 气体和湿度侦测传感器
- 需要真空及其他大气环境下进行特征测试的电子器件



# MPP

## 集成多轴磁场仿真性能的多功能探针台

- 可用于以下产品最终测试和校正
  - 磁力计及其他半导体电子器件

